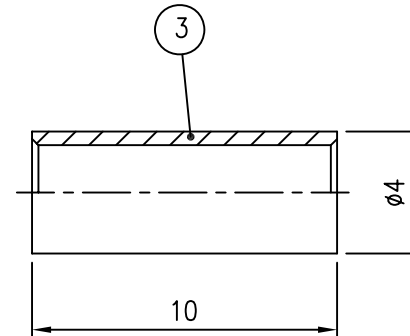
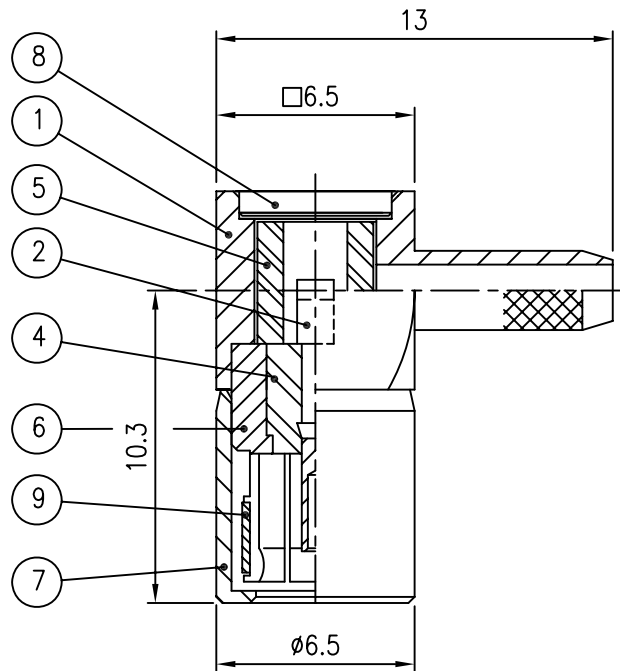


수 정 내 용									
ST	가공								
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일					
△1	[첨변처리No.201606-0001]Cover 들뜸 및 비정상적으로 현저 있는 현상으로 인한 Cover CODE 변경	김찬경	김인철	2016. 06. 09.					
△									



9	SPRING RING	1	BeCu		DSR00006-N45/1 (R3005)
8	COVER	1	MBsBD	Gold Plate	DCO00026-5/2 DCO00031-5/1 (4.2013)
7	CAP	1	MBsBD	Gold Plate	DCU00027-135/1 (K3013)
6	JACK	1	MBsBD	Gold Plate	DJA00030-135/1 (J3024)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00925-N/1 (H3115)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00349-N/1 (H3114)
3	FERRULE	1	TEFLON	Gold Plate	DFO00041-145/1 (F3009)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00367-1345/1 (E3131)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00508-135/1 (D3130)

대체가능재질	품 번		수량	재 질	표면처리	비 고	
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일 2006. 6. 9.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.			
	승인	김 인 철					
	재질	검도	이 현 진		도명	SSM75-LPC-179DS	
		재도	김 찬 경				
열처리	작성부서 연 구 소			A4	도번	CN00221-7/1	
보호파막처리	척도 4/1	단위 mm	중량			K315-141-075	